

2022-2028年中国封装基板 行业发展趋势与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国封装基板行业发展趋势与投资前景分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202112/251650.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

封装基板是芯片封装体的重要组成材料，主要起承载保护芯片与连接上层芯片和下层电路板作用。封装基板作为芯片封装的核心材料，一方面能够保护、固定、支撑芯片，增强芯片导热散热性能，保证芯片不受物理损坏，另一方面封装基板的上层与芯片相连，下层和印刷电路板相连，以实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以及沟通芯片内部与外部电路等功能。随着封装技术向多引脚、窄间距、小型化的趋势发展，封装基板已经逐渐成为主流封装材料。

从全球封装基板的市场格局来看，目前主要产能和生产商都集中在台湾、韩国、日本等地区，前十大企业中台湾、韩国、日本地区分别占4个、3个、3个，合计市占率达到80%、集中度较高。全球封装基板地区分布

国家/地区	按制造地	按归属地区
中国台湾	31%	38%
韩国	28%	28%
日本	20%	26%
中国大陆	16%	4%
其他	5%	3%

数据来源：公开资料整理

中企顾问网发布的《2022-2028年中国封装基板行业发展趋势与投资前景分析报告》共十四章。首先介绍了中国封装基板行业市场发展环境、封装基板整体运行态势等，接着分析了中国封装基板行业市场运行的现状，然后介绍了封装基板市场竞争格局。随后，报告对封装基板做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国封装基板行业发展趋势与投资预测。您若想对封装基板产业有个系统的了解或者想投资中国封装基板行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 封装基板行业发展综述

1.1 封装基板行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业产品/服务分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 封装基板行业特征分析

1.2.1 产业链分析

- 1.2.2 封装基板行业在产业链中的地位
- 1.2.3 封装基板行业生命周期分析
 - (1) 行业生命周期理论基础
 - (2) 封装基板行业生命周期
- 1.3 中国封装基板所属行业经济指标分析
 - 1.3.1 赢利性
 - 1.3.2 成长速度
 - 1.3.3 附加值的提升空间
 - 1.3.4 进入壁垒 / 退出机制
 - 1.3.5 风险性
 - 1.3.6 行业周期
 - 1.3.7 竞争激烈程度指标
 - 1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 封装基板所属行业运行环境（PEST）分析

- 2.1 封装基板行业政治法律环境分析
 - 2.1.1 行业管理体制分析
 - 2.1.2 行业主要法律法规
 - 2.1.3 行业相关发展规划
- 2.2 封装基板行业经济环境分析
 - 2.2.1 国际宏观经济形势分析
 - 2.2.2 国内宏观经济形势分析
 - 2.2.3 产业宏观经济环境分析
- 2.3 封装基板行业社会环境分析
 - 2.3.1 封装基板产业社会环境
 - 2.3.2 社会环境对行业的影响
 - 2.3.3 封装基板产业发展对社会发展的影响
- 2.4 封装基板行业技术环境分析
 - 2.4.1 封装基板技术分析
 - 2.4.2 封装基板技术发展水平
 - 2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国封装基板所属行业运行分析

3.1 我国封装基板所属行业发展状况分析

3.1.1 我国封装基板行业发展阶段

3.1.2 我国封装基板行业发展总体概况

3.1.3 我国封装基板行业发展特点分析

3.2 2015-2019年封装基板所属行业发展现状

3.2.1 2015-2019年我国封装基板行业市场规模

3.2.2 2015-2019年我国封装基板行业发展分析

3.2.3 2015-2019年中国封装基板企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2015-2019年重点省市市场分析

3.4 封装基板细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2015-2019年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 封装基板产品/服务价格分析

3.5.1 2015-2019年封装基板价格走势

3.5.2 影响封装基板价格的关键因素分析

(1) 成本

(2) 供需情况

(3) 关联产品

(4) 其他

3.5.3 2022-2028年封装基板产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要封装基板企业价位及价格策略

第四章 我国封装基板所属行业整体运行指标分析

4.1 2015-2019年中国封装基板所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2015-2019年中国封装基板所属行业运营情况分析

4.2.1 我国封装基板行业营收分析

4.2.2 我国封装基板行业成本分析

4.2.3 我国封装基板行业利润分析

4.3 2015-2019年中国封装基板所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国封装基板所属行业供需形势分析

5.1 封装基板行业供给分析

5.1.1 2015-2019年封装基板行业供给分析

5.1.2 2022-2028年封装基板行业供给变化趋势

5.1.3 封装基板行业区域供给分析

5.2 2015-2019年我国封装基板行业需求情况

5.2.1 封装基板行业需求市场

5.2.2 封装基板行业客户结构

5.2.3 封装基板行业需求的地区差异

5.3 封装基板市场应用及需求预测

5.3.1 封装基板应用市场总体需求分析

(1) 封装基板应用市场需求特征

(2) 封装基板应用市场需求总规模

5.3.2 2022-2028年封装基板行业领域需求量预测

(1) 2022-2028年封装基板行业领域需求产品/服务功能预测

(2) 2022-2028年封装基板行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业封装基板产品/服务需求分析预测

第六章 封装基板所属行业产业结构分析

6.1 封装基板产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

- 6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例
- 6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）
- 6.2 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
 - 6.2.1 产业价值链的构成
 - 6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析
- 6.3 产业结构发展预测
 - 6.3.1 产业结构调整指导政策分析
 - 6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素
 - 6.3.3 中国封装基板行业参与国际竞争的战略市场定位
 - 6.3.4 封装基板产业结构调整方向分析

第七章 我国封装基板行业产业链分析

- 7.1 封装基板行业产业链分析
 - 7.1.1 产业链结构分析
 - 7.1.2 主要环节的增值空间
 - 7.1.3 与上下游行业之间的关联性
- 7.2 封装基板上游行业分析
 - 7.2.1 封装基板产品成本构成
 - 7.2.2 2015-2019年上游行业发展现状
 - 7.2.3 2022-2028年上游行业发展趋势
 - 7.2.4 上游供给对封装基板行业的影响
- 7.3 封装基板下游行业分析
 - 7.3.1 封装基板下游行业分布
 - 7.3.2 2015-2019年下游行业发展现状
 - 7.3.3 2022-2028年下游行业发展趋势
 - 7.3.4 下游需求对封装基板行业的影响

第八章 我国封装基板所属行业渠道分析及策略

- 8.1 封装基板行业渠道分析
 - 8.1.1 渠道形式及对比
 - 8.1.2 各类渠道对封装基板行业的影响
 - 8.1.3 主要封装基板企业渠道策略研究

8.1.4 各区域主要代理商情况

8.2 封装基板行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 封装基板行业营销策略分析

8.3.1 中国封装基板营销概况

8.3.2 封装基板营销策略探讨

8.3.3 封装基板营销发展趋势

第九章 我国封装基板所属行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 封装基板行业竞争结构分析

(1) 现有企业间竞争

(2) 潜在进入者分析

(3) 替代品威胁分析

(4) 供应商议价能力

(5) 客户议价能力

(6) 竞争结构特点总结

9.1.2 封装基板行业企业间竞争格局分析

9.1.3 封装基板行业集中度分析

9.1.4 封装基板行业SWOT分析

9.2 中国封装基板行业竞争格局综述

9.2.1 封装基板行业竞争概况

(1) 中国封装基板行业竞争格局

(2) 封装基板行业未来竞争格局和特点

(3) 封装基板市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国封装基板行业竞争力分析

(1) 我国封装基板行业竞争力剖析

(2) 我国封装基板企业市场竞争的优势

(3) 国内封装基板企业竞争能力提升途径

9.2.3 封装基板市场竞争策略分析

第十章 封装基板行业领先企业经营形势分析

从全球封装基板制造企业类型来看，主要可分三大部分：1)由封测厂商投建的 IC 封装基板生产厂，如日月光等企业；2)由 PCB 厂商拓展业务至封装基板，封装基板与 PCB 中的 HDI 板在制造工艺上存在一定共通之处，属于技术同源，比如我国深南电路；3)专门生产封装基板的厂商，包括信泰电子等。从主要封装基板厂商企业类型看，当前 PCB 厂占据行业主流。作为集成电路产业链中的关键配套材料，中国大陆封装基板的全球占有率仅为 1.23%，国产封装基板占比更少，可见国产替代空间较大。全球主要封装基板厂商

公司	国家/地区	成立时间	主要封装基板产品	主要客户	企业特点
欣兴集团 (UMTC)	中国台湾	1990	WBCSP、WBBGA、FCCSP、FCBGA、PoP 和 Hybrid	高通、博通、英特尔、超威半导体和英伟达	PCB 厂
Ibiden	日本	1912	FCBGAA、FCCSP	苹果、三星	PCB 厂
三星机电 (SEMCO)	韩国	1973	FCCSP、FCBGA 和 RF Module	封装基板 高通、三星、苹果	PCB 厂
南亚电路 (Nan Ya PCB)	中国台湾	1997	C、WB	英特尔、超威半导体、英特尔、博通和三星	PCB 厂
景硕科技 (Kinsus)	中国台湾	2000	WBPBGA、WBCSP、EBGA、SiP、FCCSP、FCBGA、COP、COF 等	高通、英特尔、博通	基板厂
神钢 (Shinko)	日本	1917	IC 载板和 FC 基板	英特尔的 FC 载板供应商	PCB 厂
信泰电子 Simmtech	韩国	1987	PBGA/CSP、BOC、FMC、MCP/UTCSP 及 FCCSP	三星、Hitech 半导体、LG、摩托罗拉、SanDisk	基板厂
大德 (Daeduck)	韩国	1965	IC 载板	PCB 厂	日月光 (ASE Material)
日月光 (ASE Material)	中国台湾	1984	IC 载板	日月光等	封测厂
京瓷 (Kyocera)	日本	1950	倒装芯片封装、模块基板、基层电路板、高密度多层印制电路板	索尼第三代游戏机用 FC 载板的主要供应商	PCB 厂
伊诺特 (LGINnotech)	韩国	1970	FCBGA、FCCSP、WBPBGA 和 RF Module	封装基板 高通	PCB 厂

数据来源：公开资料整理

10.1 甘肃银光化学工业集团有限公司

10.1.1 企业发展基本情况

10.1.2 企业主要产品分析

10.1.3 企业竞争优势分析

10.1.4 企业经营状况分析

10.1.5 企业最新发展动态

10.1.6 企业发展战略分析

10.2 上海中联化工厂

10.2.1 企业发展基本情况

10.2.2 企业主要产品分析

10.2.3 企业竞争优势分析

10.2.4 企业经营状况分析

10.2.5 企业最新发展动态

10.2.6 企业发展战略分析

10.3 重庆长风化工厂

10.3.1 企业发展基本情况

10.3.2 企业主要产品分析

10.3.3 企业竞争优势分析

10.3.4 企业经营状况分析

10.3.5 企业最新发展动态

10.3.6 企业发展战略分析

10.4 德国拜耳集团（Bayer）

10.4.1 企业发展基本情况

10.4.2 企业主要产品分析

10.4.3 企业竞争优势分析

10.4.4 企业经营状况分析

10.4.5 企业最新发展动态

10.4.6 企业发展战略分析

10.5 宁波万华聚氨酯有限公司

10.5.1 企业发展基本情况

10.5.2 企业主要产品分析

10.5.3 企业竞争优势分析

10.5.4 企业经营状况分析

10.5.5 企业最新发展动态

10.5.6 企业发展战略分析

第十一章 2022-2028年封装基板行业投资前景

11.1 2022-2028年封装基板市场发展前景

11.1.1 2022-2028年封装基板市场发展潜力

11.1.2 2022-2028年封装基板市场发展前景展望

11.1.3 2022-2028年封装基板细分行业发展前景分析

11.2 2022-2028年封装基板市场发展趋势预测

- 11.2.1 2022-2028年封装基板行业发展趋势
- 11.2.2 2022-2028年封装基板市场规模预测
- 11.2.3 2022-2028年封装基板行业应用趋势预测
- 11.2.4 2022-2028年细分市场发展趋势预测
- 11.3 2022-2028年中国封装基板行业供需预测
 - 11.3.1 2022-2028年中国封装基板行业供给预测
 - 11.3.2 2022-2028年中国封装基板行业需求预测
 - 11.3.3 2022-2028年中国封装基板供需平衡预测
- 11.4 影响企业生产与经营的关键趋势
 - 11.4.1 市场整合成长趋势
 - 11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测
 - 11.4.3 企业区域市场拓展的趋势
 - 11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展
 - 11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2022-2028年封装基板行业投资机会与风险

- 12.1 封装基板行业投融资情况
 - 12.1.1 行业资金渠道分析
 - 12.1.2 固定资产投资分析
 - 12.1.3 兼并重组情况分析
- 12.2 2022-2028年封装基板行业投资机会
 - 12.2.1 产业链投资机会
 - 12.2.2 细分市场投资机会
 - 12.2.3 重点区域投资机会
- 12.3 2022-2028年封装基板行业投资风险及防范
 - 12.3.1 政策风险及防范
 - 12.3.2 技术风险及防范
 - 12.3.3 供求风险及防范
 - 12.3.4 宏观经济波动风险及防范
 - 12.3.5 关联产业风险及防范
 - 12.3.6 产品结构风险及防范
 - 12.3.7 其他风险及防范

第十三章 封装基板行业投资战略研究

13.1 封装基板行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国封装基板品牌的战略思考

13.2.1 封装基板品牌的重要性

13.2.2 封装基板实施品牌战略的意义

13.2.3 封装基板企业品牌的现状分析

13.2.4 我国封装基板企业的品牌战略

13.2.5 封装基板品牌战略管理的策略

13.3 封装基板经营策略分析

13.3.1 封装基板市场细分策略

13.3.2 封装基板市场创新策略

13.3.3 品牌定位与品类规划

13.3.4 封装基板新产品差异化战略

13.4 封装基板行业投资战略研究

13.4.1 2019年封装基板行业投资战略

13.4.2 2022-2028年封装基板行业投资战略

13.4.3 2022-2028年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议（ ）

14.1 封装基板行业研究结论

14.2 封装基板行业投资价值评估

14.3 封装基板行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建（）

图表目录：

图表1：封装基板行业生命周期

图表2：封装基板行业产业链结构

图表3：2015-2019年全球封装基板行业市场规模

图表4：2015-2019年中国封装基板行业市场规模

图表5：2015-2019年封装基板行业重要数据指标比较

图表6：2015-2019年中国封装基板市场占全球份额比较

图表7：2015-2019年封装基板行业工业总产值

图表8：2015-2019年封装基板行业销售收入

图表9：2015-2019年封装基板行业利润总额

图表10：2015-2019年封装基板行业资产总计

图表11：2015-2019年封装基板行业负债总计

图表12：2015-2019年封装基板行业竞争力分析

图表13：2015-2019年封装基板市场价格走势

图表14：2015-2019年封装基板行业主营业务收入

图表15：2015-2019年封装基板行业主营业务成本

图表16：2015-2019年封装基板行业销售费用分析

图表17：2015-2019年封装基板行业管理费用分析

图表18：2015-2019年封装基板行业财务费用分析

图表19：2015-2019年封装基板行业销售毛利率分析

图表20：2015-2019年封装基板行业销售利润率分析

图表21：2015-2019年封装基板行业成本费用利润率分析

图表22：2015-2019年封装基板行业总资产利润率分析

图表23：2015-2019年封装基板行业集中度

图表24：2022-2028年中国封装基板行业供给预测

图表25：2022-2028年中国封装基板行业需求预测

图表26：2022-2028年中国封装基板行业市场容量预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202112/251650.html>